

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Point72、佰耀资本、北京中富嘉合国际投资、博时基金、诚域基金、东北证券、东方阿尔法基金、东方财富证券、富荣基金、歌汝资产、广东华辉创富、广东五原集团、国盛证券、国信证券、华创证券、华福证券、华能贵诚信托、怀新投资、建信基金、平安证券、泉果基金、深圳创华投资、天风证券、顽岩资产、西南证券、招商证券、中邮保险资管
时间	2026年6月4日 下午 14:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>介绍了公司的基本情况并回复了投资者关注的主要问题，具体如下：</p> <p>1、公司的研发费用较高的原因？</p> <p>答：公司2026年第一季度的研发费用为3,020.99万元，同比增长30.22%。研发费用较高是由于公司处于技术密集型行业，为了持续保持技术优势、突破技术瓶颈、完善产品结构，公司需要持续投入大量资金用于产品研发、改进和验证。</p> <p>2、公司在产能规划方面有怎样的计划？</p>

答：由于今年市场订单需求较为旺盛，公司年初开始启动，产能扩张有序。公司在香港和马来西亚设立了全资子公司，通过当地员工进行海外市场开拓，为海外客户提供更多本土化和即时性的服务。公司深化与海外头部客户的协同合作机制，通过本地化技术支持与区域化服务网络建设，深度挖掘海外市场潜力。

3、公司的主营业务覆盖哪些板块？

答：公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。以及新推出的AI SOC 高性能集成电路测试设备。

4、在AI SOC测试机方面公司进展如何？

答：公司已推出面向人工智能系统级芯片（AI SoC）设计的新一代高端测试系统——“液冷数字AI SoC测试机QT-9800”。该产品旨在解决 AI 芯片在高功率、高精度、多通道并行测试能力及平台兼容性的关键难题。QT-9800测试系统是公司未来重点发展的核心产品。公司将加大市场推广和应用开发，积极推动该产品的客户验证和量产。

5、对测试机市场未来的发展公司是如何判断的？

答：受益于人工智能、汽车电子、工业物联网、消费电子需求回暖趋势推动，行业呈现逐步复苏态势。当前功率半导体市场持续扩容，受汽车、工业自动化、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，功率半导体市场规模快速增长。碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、

高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域应用潜力巨大。随着产业链规模化降本、产能扩张及技术创新催生的新应用场景不断涌现，该领域市场空间将持续拓展。与此同时，AI算力芯片、车规级半导体及存储芯片测试需求快速增长，叠加SiC、GaN等第三代半导体材料在功率器件领域渗透率提升，将带动高精度、大功率器件测试设备需求进一步放量。因此，行业未来发展持续向好。

6、KGD测试与CP、FT测试的区别是什么？

答：KGD测试介于CP测试和FT测试之间：CP测试主要做简单电气性能测试；KGD测试侧重高压、更高负荷的性能测试，目的是避免芯片切开封装成模块后因单个芯片问题导致整个模块报废。

7、公司主要的客户有哪些？

答：公司持续深耕大功率器件、模块及第三代半导体测试领域，依托国内领先的技术研发能力，通过战略聚焦与市场拓展双轨驱动，成功实现业务规模与客户质量的同步提升。公司不仅与安森美集团、力特半导体、威世集团等国际头部企业及芯联集成、中国中车、三安光电、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技等本土领军企业保持深度合作，更成功突破多家芯片设计厂商的供应链体系，客户结构持续优化。公司近几年自主研发的QT-8400系列测试平台在碳化硅/氮化镓等第三代半导体晶圆及模块全性能测试领域形成技术壁垒，量产出货加速，客户数量稳步增长。新研发的QT-9800EXA已经与天数智芯签订战略合作协议，未来也将持续进行行业其他客户的导入。

8、如何看待AI SOC测试机的国产化需求？

答：目前SoC测试系统的国产化率很低，进口替代的空间巨大。公司的QT-9800在液冷散热、高电流、高通道数的关键性能指标上已经对标进口产品；同时兼具性价比突出和无需海外厂商高额维护、升级费用的优势；本地化交付和服务能够减少供应和验证周期，大幅度降低客户的综合使用成本。未来公司将会继续加强技术自研和生产优化，着力降低成本，提高量产后的毛利率。

9、公司是否考虑通过并购扩大业务体量？

答：公司在目前内生增长驱动业绩提升的基础上，积极进行外部布局的探索，适时完善平台化布局。公司将寻求产业链中整合度较高的并购标的或技术团队，做上下游或横向并购的尝试。未来如有相关计划，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

10、公司在半导体测试领域的技术布局和未来规划是什么？

答：在AI算力方面，公司重点推广自主研发的"液冷数字AI SoC测试机QT-9800EXA"，该产品旨在解决AI芯片在高功率、高精度、多通道并行测试等关键难题。公司将加大市场推广力度，积极推动该产品在AI芯片设计企业的验证和量产应用。在第三代半导体方面，公司将持续深化在SiC/GaN功率器件测试领域的技术优势，重点拓展电动汽车、新能源等工业应用场景，把握未来AI电源以及相关行业对三代半功率器件的需求增长。QT-8400系列测试平台已在下游客户实现批量销售，公司将积极面向车规级SiC器件制造商推广。公司将持续加大研发投入，重点推进数模混合集成电路、SoC类大规模数字集成电路领域的测试方案落地，同时深化功率半导体测试系统的技术迭代，全面提升测试能力和效率。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月4日